

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年5月2日(02.05.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/089923 A1

(51) 国際特許分類:
C09K 3/14 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C01F 17/235 (2020.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/017469

(22) 国際出願日: 2023年5月9日(09.05.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-172587 2022年10月27日(27.10.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 影澤 幸一 (KAGESAWA Koichi); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 李相哲 (LEE Sangchul); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 久保 拓夢 (KUBO Hiromu); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: RAW MATERIAL FOR OBTAINING ABRASIVE GRAINS AND SELECTION METHOD THEREFOR, PRODUCTION METHOD FOR ABRASIVE GRAINS, PRODUCTION METHOD FOR POLISHING LIQUID, POLISHING METHOD, PRODUCTION METHOD FOR COMPONENT, AND PRODUCTION METHOD FOR SEMI-CONDUCTOR COMPONENT

(54) 発明の名称: 砥粒を得るための原料及びその選定方法、砥粒の製造方法、研磨液の製造方法、研磨方法、部品の製造方法、並びに、半導体部品の製造方法

(57) Abstract: Provided is a selection method for a raw material for obtaining abrasive grains, wherein the raw material contains cerium, and the raw material is selected on the basis of a peak top temperature in a differential curve of a thermogravimetric curve obtained by thermogravimetric analysis of the raw material. The present invention also provides a raw material for obtaining abrasive grains, said raw material containing cerium and having a peak top temperature of 300°C or higher in a differential curve of a thermogravimetric curve obtained by thermogravimetric analysis of the raw material. A production method for abrasive grains, wherein the raw material is pulverized. A production method for a polishing liquid, wherein the abrasive grains obtained by the aforementioned production method for abrasive grains are mixed with water. A polishing method for polishing a member to be polished by using the polishing liquid obtained by the aforementioned production method for a polishing liquid.

(57) 要約: 砥粒を得るための原料の選定方法であって、前記原料がセリウムを含み、前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき前記原料を選定する、原料の選定方法。砥粒を得るための原料であって、セリウムを含み、前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度が300℃以上である、原料。前記原料を粉砕する、砥粒の製造方法。前記砥粒の製造方法により得られた砥粒と、水と、を混合する、研磨液の製造方法。前記研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いて被研磨部材を研磨する、研磨方法。

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）

明 細 書

発明の名称：

砥粒を得るための原料及びその選定方法、砥粒の製造方法、研磨液の製造方法、研磨方法、部品の製造方法、並びに、半導体部品の製造方法

技術分野

[0001] 本開示は、砥粒を得るための原料及びその選定方法、砥粒の製造方法、研磨液の製造方法、研磨方法、部品の製造方法、半導体部品の製造方法等に関する。

背景技術

[0002] 近年の電子デバイスの製造工程では、高密度化、微細化等のための加工技術の重要性がますます高まっている。加工技術の一つであるCMP（ケミカル・メカニカル・ポリッシング：化学機械研磨）技術は、電子デバイスの製造工程において、シャロートレンチ分離（シャロー・トレンチ・アイソレーション：STI）の形成、プリメタル絶縁材料又は層間絶縁材料の平坦化、プラグ又は埋め込み金属配線の形成等に必須の技術となっている。CMPに用いられる研磨液としては、セリウムを含む砥粒を含有する研磨液が知られている（例えば、下記特許文献1及び2参照）。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開平10-106994号公報

特許文献2：特開平08-022970号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 研磨液において用いられる砥粒は、砥粒を得るための原料に対して粉碎処理等の処理を施すことにより得ることができる。このような砥粒を含有する研磨液に対しては、用途に応じて被研磨材料の研磨速度を調整することが求

められ、被研磨材料の研磨速度を調整するための新たな手法が求められる。
また、砥粒を含有する研磨液に対しては、パターンウエハにおける酸化ケイ素の研磨速度を高めることが求められる場合があり、例えば、線幅 $50\mu\text{m}$ ／ $50\mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン（Line）／酸化ケイ素パターン（Space）を有するパターン領域（線幅 $50\mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン及び線幅 $50\mu\text{m}$ の直線状の酸化ケイ素パターンが交互に配列されたパターン領域）における酸化ケイ素の研磨速度を高めることが求められる場合がある。

[0005] 本開示の一側面は、砥粒を得るための原料の選定方法であって、砥粒を用いて被研磨材料を研磨した場合における被研磨材料の研磨速度を調整することが可能な原料の選定方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、線幅 $50\mu\text{m}$ ／ $50\mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパターン領域における酸化ケイ素の研磨速度が高い砥粒を得ることが可能な原料を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記原料を用いた砥粒の製造方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記砥粒の製造方法により得られた砥粒を用いた研磨液の製造方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いた研磨方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いた部品の製造方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いた半導体部品の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本開示は、いくつかの側面において、下記の[1]～[13]等に関する。

[1] 砥粒を得るための原料の選定方法であって、前記原料がセリウムを含み、前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき前記原料を選定する、原料の選定方法。

〔２〕前記原料がセリウム酸化物を含む、〔１〕に記載の原料の選定方法。

〔３〕砥粒を得るための原料であって、セリウムを含み、前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度が３００℃以上である、原料。

〔４〕セリウム酸化物を含む、〔３〕に記載の原料。

〔５〕トリメシン酸のセリウム錯体由来のセリウム酸化物を含む、〔３〕又は〔４〕に記載の原料。

〔６〕ステアリン酸セリウム由来のセリウム酸化物を含む、〔３〕～〔５〕のいずれか一つに記載の原料。

〔７〕水酸化セリウム由来のセリウム酸化物を含む、〔３〕～〔６〕のいずれか一つに記載の原料。

〔８〕〔１〕又は〔２〕に記載の原料の選定方法により選定された原料、又は、〔３〕～〔７〕のいずれか一つに記載の原料を粉碎する、砥粒の製造方法。

〔９〕〔８〕に記載の砥粒の製造方法により得られた砥粒と、水と、を混合する、研磨液の製造方法。

〔１０〕〔９〕に記載の研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いて被研磨部材を研磨する、研磨方法。

〔１１〕前記被研磨部材が酸化ケイ素を含む、〔１０〕に記載の研磨方法。

〔１２〕〔１０〕又は〔１１〕に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。

〔１３〕〔１０〕又は〔１１〕に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。

発明の効果

〔０００７〕 本開示の一側面によれば、砥粒を得るための原料の選定方法であって、砥粒を用いて被研磨材料を研磨した場合における被研磨材料の研磨速度を調整することが可能な原料の選定方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、線幅５０μｍ／５０μｍの直線状の窒化ケイ素パターン／酸

化ケイ素パターンを有するパターン領域における酸化ケイ素の研磨速度が高い砥粒を得ることが可能な原料を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記原料を用いた砥粒の製造方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記砥粒の製造方法により得られた砥粒を用いた研磨液の製造方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いた研磨方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いた部品の製造方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いた半導体部品の製造方法を提供することができる。

発明を実施するための形態

[0008] 以下、本開示の実施形態について説明する。但し、本開示は下記実施形態に限定されるものではない。

[0009] 本明細書において、「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。数値範囲の「A以上」とは、A、及び、Aを超える範囲を意味する。数値範囲の「A以下」とは、A、及び、A未満の範囲を意味する。本明細書に段階的に記載されている数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値又は下限値は、他の段階の数値範囲の上限値又は下限値と任意に組み合わせることができる。本明細書に記載されている数値範囲において、その数値範囲の上限値又は下限値は、実験例に示されている値に置き換えてもよい。「A又はB」とは、A及びBのどちらか一方を含んでいればよく、両方とも含んでいてもよい。本明細書に例示する材料は、特に断らない限り、1種を単独で又は2種以上を組み合わせ用いることができる。組成物中の各成分の含有量は、組成物中に各成分に該当する物質が複数存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味する。「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別できない場合であってもその工程の所期の作用が達成されれば、本用語に含まれる。「砥粒」とは、

複数の粒子の集合を意味するが、便宜的に、砥粒を構成する一の粒子を砥粒と呼ぶことがある。

[0010] 本実施形態に係る原料及びその選定方法は、砥粒（研磨液に用いられる砥粒）を得るための原料及びその選定方法である。本実施形態に係る原料及びその選定方法において、原料はセリウムを含む。本実施形態に係る原料の選定方法では、原料を熱重量分析（TGA）して得られる熱重量曲線（TG曲線）の微分曲線（DTG曲線）におけるピークトップ温度に基づき原料を選定する。本実施形態に係る原料は、用途に応じて、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度として任意の数値を有する。本実施形態に係る原料の形状は、特に限定されず、例えば、粒子状、繊維状、フレーク状、液状（例えば高粘性の液状）等であってよい。

[0011] 本発明者は、粉碎処理等の処理を施すことにより砥粒を得るための原料として、セリウムを含む原料に着目した上で、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度を調整することにより、砥粒を用いて被研磨材料を研磨した場合における被研磨材料の研磨速度を調整できることを見出した。本実施形態に係る原料及びその選定方法によれば、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき原料を選定し、このような原料を用いて砥粒を得ることにより、砥粒を用いて被研磨材料を研磨した場合における被研磨材料の研磨速度を調整することができる。本実施形態に係る原料及びその選定方法によれば、原料に対して粉碎処理（粉碎処理後に分級処理により特定の粒径に揃えてよい）を施して砥粒を得た際に、砥粒を用いて被研磨材料を研磨した場合における被研磨材料の研磨速度を調整することができる。本実施形態によれば、砥粒を得るための原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき被研磨材料の研磨速度を調整する、研磨速度の調整方法を提供することができる。

[0012] 本実施形態に係る原料及びその選定方法の一態様によれば、パターンウエハにおける被研磨材料の研磨速度を調整することができる。本実施形態に係

る原料及びその選定方法の一態様によれば、被研磨材料の研磨速度を増加させるように被研磨材料の研磨速度を調整することが可能であり、被研磨材料の研磨速度を減少させるように被研磨材料の研磨速度を調整することもできる。本実施形態に係る原料及びその選定方法の一態様によれば、絶縁材料の研磨速度を調整することが可能であり、酸化ケイ素の研磨速度を調整することができる。

[0013] 砥粒を得るための原料は、セリウム（セリウム元素）を含み、セリウム化合物を含んでよい。セリウム化合物としては、セリウム酸化物、セリウム水酸化物、硝酸アンモニウムセリウム、酢酸セリウム、硫酸セリウム（例えば硫酸セリウム水和物）、臭素酸セリウム、臭化セリウム、塩化セリウム、シュウ酸セリウム、硝酸セリウム、炭酸セリウム等が挙げられる。砥粒を得るための原料は、被研磨材料の研磨速度を調整しやすい観点、又は、被研磨材料の研磨速度（パターンウエハにおける酸化ケイ素の研磨速度等；以下同様）を高めやすい観点から、セリウム酸化物を含んでよい。セリウム酸化物は、 CeO_2 （酸化セリウム（Ⅳ）、セリア）であってよく、 Ce_2O_3 （酸化セリウム（Ⅲ））であってよい。

[0014] 砥粒を得るための原料は、セリウムを含むセリウム源を酸化することにより得てよい。酸化の方法としては、セリウム源を600～900℃等で焼成する焼成法；過酸化水素等の酸化剤を用いてセリウム源を酸化する化学的酸化法などが挙げられる。砥粒を得るための原料は、セリウム源由来のセリウム酸化物を含んでよく、セリウム源の焼成物を含んでよい。セリウム源としては、セリウム塩を用いてよく、セリウム錯体を用いてよい。砥粒を得るための原料は、セリウム塩由来のセリウム酸化物を含んでよく、セリウム錯体由来のセリウム酸化物を含んでよい。

[0015] セリウム錯体は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、炭素鎖を有する化合物Aのセリウム錯体（化合物Aの配位子と、セリウムと、を有する錯体）を含んでよい。化合物Aは、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、カルボキシ基及びカルボン酸塩基からなる群より選ばれる少なくとも

も一種を含んでよい。この場合、カルボキシ基の数、又は、カルボキシ基及びカルボン酸塩基の合計数は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、1～4、1～3、2～4、2～3、又は、3～4であってよい。化合物Aは、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、鎖状（非環式）の炭素鎖及び環状の炭素鎖からなる群より選ばれる少なくとも一種を有してよく、環状の炭素鎖を有してよい。環状の炭素鎖は、脂環、複素環又は芳香環であってよい。化合物Aは、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、芳香環を有してよい。セリウム錯体は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、芳香族カルボン酸のセリウム錯体を含んでよく、ベンゼントリカルボン酸のセリウム錯体を含んでよく、トリメシン酸のセリウム錯体を含んでよい。セリウム錯体は、金属有機構造体（Metal Organic Frameworks）を含んでよい。

[0016] セリウム源としては、炭酸セリウム（オキシ炭酸セリウムを除く）、オキシ炭酸セリウム、トリメシン酸のセリウム錯体、酢酸セリウム、ステアリン酸セリウム、硝酸セリウム、硫酸セリウム、シュウ酸セリウム、水酸化セリウム等が挙げられる。砥粒を得るための原料は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、トリメシン酸のセリウム錯体由来のセリウム酸化物（例えば、トリメシン酸のセリウム錯体の焼成物）、ステアリン酸セリウム由来のセリウム酸化物（例えば、ステアリン酸セリウムの焼成物）、及び、水酸化セリウム由来のセリウム酸化物（例えば、水酸化セリウムの焼成物）からなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。すなわち、砥粒を得るための原料は、トリメシン酸のセリウム錯体由来のセリウム酸化物を含む態様、ステアリン酸セリウム由来のセリウム酸化物を含む態様、又は、水酸化セリウム由来のセリウム酸化物を含む態様であってよい。

[0017] 本発明者は、熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度として300℃以上を有する原料を用いて得られる砥粒により、パターンウエハにおける酸化ケイ素の研磨速度を高めやすいことを見出し、特に、線幅50μm／50μmの直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパタ

ーン領域（線幅 $50\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン及び線幅 $50\ \mu\text{m}$ の直線状の酸化ケイ素パターンが交互に配列されたパターン領域）における酸化ケイ素の研磨速度を高めやすいことを見出した。本実施形態に係る原料の一態様は、砥粒を得るための原料であって、セリウムを含み、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度が 300°C 以上である。このような原料によれば、パターンウエハにおける酸化ケイ素の研磨速度を高めやすく、特に、線幅 $50\ \mu\text{m}/50\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパターン領域における酸化ケイ素の研磨速度を高めやすい。本実施形態に係る原料の一態様によれば、後述の実験例に記載の評価方法において、線幅 $50\ \mu\text{m}/50\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパターン領域における酸化ケイ素の研磨速度として、例えば $13\ \text{nm}/\text{min}$ 以上（好ましくは、 $15\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $20\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $25\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $30\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $35\ \text{nm}/\text{min}$ 以上等）を得ることができる。

[0018] 本実施形態に係る原料の一態様によれば、線幅 $20\ \mu\text{m}/80\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパターン領域（線幅 $20\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン及び線幅 $80\ \mu\text{m}$ の直線状の酸化ケイ素パターンが交互に配列されたパターン領域）における酸化ケイ素の研磨速度を高めやすい。本実施形態に係る原料の一態様によれば、後述の実験例に記載の評価方法において、線幅 $20\ \mu\text{m}/80\ \mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン／酸化ケイ素パターンを有するパターン領域における酸化ケイ素の研磨速度として、例えば $25.5\ \text{nm}/\text{min}$ 以上（好ましくは、 $30\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $35\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $40\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $45\ \text{nm}/\text{min}$ 以上、 $50\ \text{nm}/\text{min}$ 以上等）を得ることができる。

[0019] ピークトップ温度が大きいことにより高い研磨速度が得られやすい理由の一例としては、下記の理由等が挙げられる。但し、高い研磨速度が得られやすい理由は当該内容に限定されない。すなわち、砥粒を得るための原料におけるピークトップ温度が高いと、このような原料を用いて得られた砥粒の結

晶性が高くなる反応場が維持されやすく、酸素欠陥が少ない砥粒が得られやすい。このように砥粒内部の酸素欠陥が少ないと、研磨時において砥粒が割れにくい。そのため、砥粒の十分な機械研磨力が得られやすいことから高い研磨速度が得られやすい。

[0020] 本実施形態に係る原料の選定方法は、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき原料（砥粒を得るための原料）を選定する選定工程を備える。選定工程では、ピークトップ温度が下記のいずれかの範囲であるか否か（例えば、ピークトップ温度が300℃以上であるか否か）に基づき原料を選定してよい。

[0021] 本実施形態に係る原料及びその選定方法において、原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度は、下記の範囲であってよい。ピークトップ温度は、被研磨材料の研磨速度を調整しやすい観点から、250℃以上、260℃以上、270℃以上、280℃以上、又は、290℃以上であってよい。ピークトップ温度は、被研磨材料の研磨速度（パターンウエハにおける酸化ケイ素の研磨速度等）を高めやすい観点から、300℃以上、310℃以上、320℃以上、330℃以上、340℃以上、350℃以上、360℃以上、又は、370℃以上であってよい。ピークトップ温度は、被研磨材料の研磨速度を調整しやすい観点から、500℃以下、450℃以下、400℃以下、390℃以下、380℃以下、370℃以下、360℃以下、又は、350℃以下であってよい。これらの観点から、ピークトップ温度は、250～500℃、300～500℃、350～500℃、250～400℃、300～400℃、350～400℃、250～380℃、300～380℃、又は、350～380℃であってよい。

[0022] 原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度は、熱重量示差熱分析装置（TG-DTA）を用いて、空気気流下、測定温度範囲27～920℃、昇温速度10℃／分の条件で測定可能であり、後述の実験例に記載の方法により測定できる。熱重量分析では、原料を加熱したときの重量変化を測定できる。ピークトップ温度は、発熱ピークのピ

ークトップ温度であってよく、吸熱ピークのピークトップ温度であってよい。ピークトップ温度は、ガラス転移に伴うピークのピークトップ温度であってよい。ピークトップ温度は、砥粒を得るための原料の作製条件等により調整できる。熱重量曲線の微分曲線において複数のピークが現れる場合、ピークトップ温度としては、最も高温のピーク（例えば500℃以下のピーク）におけるピークトップ温度を対象とする。

[0023] 本実施形態に係る砥粒及びその製造方法は、セリウムを含む砥粒及びその製造方法である。本実施形態に係る砥粒の製造方法では、本実施形態に係る原料を処理することにより砥粒を得てよく、例えば、本実施形態に係る原料を粉砕することにより砥粒を得てよい。本実施形態に係る砥粒の製造方法では、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を処理することにより砥粒を得てよく、例えば、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を粉砕することにより砥粒を得てよい。本実施形態に係る砥粒は、本実施形態に係る原料を処理することにより得られた砥粒（本実施形態に係る砥粒の製造方法により得られた砥粒）であってよく、例えば、本実施形態に係る原料を粉砕することにより得られた砥粒であってよい。本実施形態に係る砥粒は、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を処理することにより得られた砥粒であってよく、例えば、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を粉砕することにより得られた砥粒であってよい。本実施形態に係る粉砕物は、本実施形態に係る原料の粉砕物であってよく、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料の粉砕物であってよい。

[0024] 砥粒は、セリウム（セリウム元素）を含み、セリウム化合物を含んでよい。セリウム化合物としては、セリウム酸化物、セリウム水酸化物、硝酸アンモニウムセリウム、酢酸セリウム、硫酸セリウム（例えば硫酸セリウム水和物）、臭素酸セリウム、臭化セリウム、塩化セリウム、シュウ酸セリウム、硝酸セリウム、炭酸セリウム等が挙げられる。砥粒は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、セリウム酸化物を含んでよい。セリウム酸化物は

、 CeO_2 （酸化セリウム（Ⅳ）、セリア）であってよく、 Ce_2O_3 （酸化セリウム（Ⅲ））であってよい。

[0025] 本実施形態に係る砥粒の製造方法は、本実施形態に係る原料を処理する処理工程を備えてよく、例えば、本実施形態に係る原料を粉砕することにより粉砕物を得る粉砕工程を備えてよい。本実施形態に係る砥粒の製造方法は、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を処理する処理工程を備えてよく、例えば、本実施形態に係る原料の選定方法により選定された原料を粉砕することにより粉砕物を得る粉砕工程を備えてよい。本実施形態に係る砥粒の製造方法は、粉砕工程の後に、粉砕物を分級する分級工程を備えてよい。分級工程では、粗大物（例えば粗大粒子）を除去することができる。粉砕工程における粉砕方法としては、特に限定されず、湿式粉砕、乾式粉砕等の各種粉砕方法を用いることができる。分級工程における分級方法としては、特に限定されず、遠心分離等が挙げられる。

[0026] 本実施形態に係る研磨液は、本実施形態に係る砥粒と、水と、を含有する。本実施形態に係る研磨液は、砥粒及び水に加えて、砥粒及び水以外の成分（例えば、後述の各種成分）を含有してよい。本実施形態に係る複数液式研磨液は、本実施形態に係る砥粒と水とを含有する液A（第1の液）、並びに、砥粒及び水以外の成分（例えば、後述の各種成分）と水とを含有する液B（第2の液）を備える。液Aは、砥粒及び水以外の成分（例えば、後述の各種成分）を含有してよく、砥粒及び水以外の成分（例えば、後述の各種成分）を含有していなくてもよい。本実施形態に係る研磨液の製造方法では、本実施形態に係る砥粒（例えば、本実施形態に係る砥粒の製造方法により得られた砥粒）と、水と、を混合することにより研磨液を得てよく、本実施形態に係る複数液式研磨液の液A及び液Bを互いに混合することにより研磨液を得てよい。液Aは、本実施形態に係る砥粒（例えば、本実施形態に係る砥粒の製造方法により得られた砥粒）と、水と、を混合することにより得ることができる。液Aは、複数の液であってよく、例えば、砥粒の種類が互いに異なる複数の液であってよい。液Bは、複数の液であってよく、例えば、砥粒

及び水以外の成分の種類が互いに異なる複数の液であってよい。

[0027] 砥粒の含有量は、研磨液の全質量又は水的全質量を基準として下記の範囲であってよい。砥粒の含有量は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.2質量%以上、0.3質量%以上、0.4質量%以上、又は、0.5質量%以上であってよい。砥粒の含有量は、研磨液の粘度の上昇、砥粒の凝集等を抑制しやすい観点から、10質量%以下、8質量%以下、5質量%以下、3質量%以下、1質量%以下、0.8質量%以下、又は、0.5質量%以下であってよい。これらの観点から、砥粒の含有量は、0.01～10質量%、0.01～5質量%、0.01～1質量%、0.05～10質量%、0.05～5質量%、0.05～1質量%、0.1～10質量%、0.1～5質量%、又は、0.1～1質量%であってよい。

[0028] 水は、研磨液から他の成分を除いた残部として含有されていればよい。水の含有量は、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。水の含有量は、90質量%以上、91質量%以上、92質量%以上、93質量%以上、94質量%以上、95質量%以上、96質量%以上、97質量%以上、98質量%以上、又は、99質量%以上であってよい。水の含有量は、100質量%未満、99.9質量%以下、99.8質量%以下、99.7質量%以下、99.6質量%以下、又は、99.5質量%以下であってよい。これらの観点から、水の含有量は、90質量%以上100質量%未満、95質量%以上100質量%未満、又は、98質量%以上100質量%未満であってよい。

[0029] 本実施形態に係る研磨液は、必要に応じてリン酸塩化合物を含有することができる。リン酸塩化合物は、砥粒の分散剤として用いてよい。リン酸塩化合物としては、リン酸塩及びその誘導体（リン酸塩誘導体）からなる群より選ばれる少なくとも一種を用いることができる。リン酸水素塩化合物としては、リン酸水素塩及びその誘導体（リン酸水素塩誘導体）からなる群より選ばれる少なくとも一種を用いることができる。

- [0030] リン酸塩としては、リン酸カリウム塩、リン酸ナトリウム塩、リン酸アンモニウム塩、リン酸カルシウム塩等が挙げられ、具体的には、リン酸三カリウム、リン酸三ナトリウム、リン酸アンモニウム、リン酸三カルシウム等が挙げられる。リン酸塩誘導体としては、二リン酸ナトリウム、二リン酸カリウム、ポリリン酸カリウム、ポリリン酸アンモニウム、ポリリン酸カルシウム等が挙げられる。
- [0031] リン酸水素塩としては、リン酸水素カリウム塩、リン酸水素ナトリウム塩、リン酸水素アンモニウム塩、リン酸水素カルシウム塩等が挙げられ、具体的には、リン酸水素二カリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素二アンモニウム、リン酸水素カルシウム、リン酸二水素カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸二水素アンモニウム、リン酸二水素カルシウム等が挙げられる。リン酸水素塩誘導体としては、リン酸水素カリウムドデシル、リン酸水素ナトリウムドデシル、リン酸水素ドデシルアンモニウム等が挙げられる。
- [0032] 本実施形態に係る研磨液は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、リン酸水素塩を含有してよく、リン酸二水素アンモニウムを含有してよい。
- [0033] リン酸塩化合物の含有量は、研磨液の全質量又は水の全質量を基準として下記の範囲であってよい。リン酸塩化合物の含有量は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、0.0001質量%以上、0.0005質量%以上、0.001質量%以上、0.002質量%以上、0.003質量%以上、0.004質量%以上、0.005質量%以上、0.008質量%以上、又は、0.01質量%以上であってよい。リン酸塩化合物の含有量は、砥粒の凝集を抑制しやすい観点から、1質量%以下、0.5質量%以下、0.1質量%以下、0.08質量%以下、0.05質量%以下、0.04質量%以下、0.03質量%以下、0.02質量%以下、又は、0.01質量%以下であってよい。これらの観点から、リン酸塩化合物の含有量は、0.0001～1質量%、0.0001～0.1質量%、0.0001～0.05質量%

％、0.001～1質量％、0.001～0.1質量％、0.001～0.05質量％、0.005～1質量％、0.005～0.1質量％、又は、0.005～0.05質量％であってよい。

[0034] リン酸塩化合物の含有量は、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。リン酸塩化合物の含有量は、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、0.01質量部以上、0.05質量部以上、0.1質量部以上、0.3質量部以上、0.5質量部以上、0.8質量部以上、1質量部以上、1.2質量部以上、1.5質量部以上、1.8質量部以上、又は、2質量部以上であってよい。リン酸塩化合物の含有量は、砥粒の凝集を抑制しやすい観点から、50質量部以下、30質量部以下、20質量部以下、10質量部以下、8質量部以下、5質量部以下、4質量部以下、3質量部以下、2.5質量部以下、又は、2質量部以下であってよい。これらの観点から、リン酸塩化合物の含有量は、0.01～50質量部、0.01～10質量部、0.01～5質量部、0.1～50質量部、0.1～10質量部、0.1～5質量部、0.5～50質量部、0.5～10質量部、0.5～5質量部、1～50質量部、1～10質量部、又は、1～5質量部であってよい。

[0035] 本実施形態に係る研磨液は、必要に応じて重合体を含有することができる。重合体としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸の単独重合体（ポリアクリル酸等）；当該単独重合体のアンモニウム塩又はアミン塩；アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸と、アクリル酸アルキル（アクリル酸メチル、アクリル酸エチル等）、アクリル酸ヒドロキシアルキル（アクリル酸ヒドロキシエチル等）、メタクリル酸アルキル（メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル等）、メタクリル酸ヒドロキシアルキル（メタクリル酸ヒドロキシエチル等）、スチレン化合物（スチレン、アルキルスチレン、スチレンスルホン酸等）、酢酸ビニル、ビニルアルコールなどの単量体との共重合体；当該共重合体のアンモニウム塩又はアミン塩などが挙げられる。本実施形態に係る研磨液は、アクリル酸及びメタクリル酸からな

る群より選ばれる少なくとも一種とスチレン化合物とを単量体単位として有する共重合体を含有してよく、スチレン及びアクリル酸を単量体単位として有する共重合体（スチレン／アクリル酸共重合体）を含有してよい。

[0036] 本実施形態に係る研磨液は、必要に応じて酸成分（但し、リン酸塩化合物に該当する化合物を除く）を含有することができる。酸成分としては、プロピオン酸、酢酸等の有機酸（アミノ酸に該当する化合物を除く）；硝酸、硫酸、塩酸、リン酸、ホウ酸等の無機酸；グリシン等のアミノ酸などが挙げられる。

[0037] 本実施形態に係る研磨液は、本実施形態に係る砥粒、水、リン酸塩化合物、重合体及び酸成分以外の成分を含有してよい。このような成分としては、特に限定されず、セリウムを含まない砥粒；塩基性化合物等が挙げられる。

[0038] 本実施形態に係る研磨液のpHは、被研磨材料の研磨速度を高めやすい観点から、下記の範囲であってよい。研磨液のpHは、1.0以上、1.5以上、2.0以上、2.5以上、3.0以上、3.5以上、4.0以上、4.5以上、5.0以上、5.5以上、6.0以上、6.5以上、7.0以上、7.0超、7.5以上、8.0以上、又は、8.5以上であってよい。研磨液のpHは、12.0以下、11.5以下、11.0以下、10.5以下、10.0以下、9.5以下、又は、9.0以下であってよい。これらの観点から、研磨液のpHは、1.0～12.0、1.0～10.0、1.0～9.0、5.0～12.0、5.0～10.0、5.0～9.0、7.0～12.0、7.0～10.0、又は、7.0～9.0であってよい。本実施形態に係る研磨液のpHは、後述の実験例に記載の方法により測定できる。

[0039] 本実施形態に係る研磨方法は、本実施形態に係る研磨液（例えば、本実施形態に係る研磨液の製造方法により得られた研磨液）を用いて被研磨部材を研磨する研磨工程を備える。研磨工程で用いられる研磨液は、本実施形態に係る複数液式研磨液の液A（第1の液）及び液B（第2の液）を混合することにより得られる研磨液であってよい。研磨工程では、被研磨部材の被研磨面を研磨することができる。研磨工程では、被研磨部材における被研磨材料

の少なくとも一部を研磨して除去することができる。被研磨材料としては、酸化ケイ素、窒化ケイ素等の絶縁材料などが挙げられる。被研磨部材は、酸化ケイ素を含んでよく、酸化ケイ素及び窒化ケイ素を含んでよい。研磨工程では、線幅 $50\mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン及び線幅 $50\mu\text{m}$ の直線状の酸化ケイ素パターンが交互に配列されたパターン領域を研磨してよく、線幅 $20\mu\text{m}$ の直線状の窒化ケイ素パターン及び線幅 $80\mu\text{m}$ の直線状の酸化ケイ素パターンが交互に配列されたパターン領域を研磨してよい。本実施形態に係る砥粒、研磨液、研磨方法等は、これらの被研磨部材の研磨に用いられることに限られず、例えば、他のパターン領域の研磨に用いられてよく、パターンを有さないブランケットウエハの研磨に用いられてよい。被研磨部材は、特に限定されず、ウエハ（例えば半導体ウエハ）であってよく、チップ（例えば半導体チップ）であってよい。被研磨部材は、配線板であってよく、回路基板であってよい。

[0040] 本実施形態に係る部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る部品作製工程を備える。本実施形態に係る部品は、本実施形態に係る部品の製造方法により得られる部品である。本実施形態に係る部品は、特に限定されず、電子部品（例えば、半導体パッケージ等の半導体部品）であってよく、ウエハ（例えば半導体ウエハ）であってよく、チップ（例えば半導体チップ）であってよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る電子部品の製造方法では、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて電子部品を得る。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る半導体部品の製造方法では、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品（例えば半導体パッケージ）を得る。本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の前に、本実施形態に係る研磨方法により被研磨部材を研磨する研磨工程を備えてよい。

[0041] 本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の一態様として、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を個片化する個片化工程

を備えてよい。個片化工程は、例えば、本実施形態に係る研磨方法により研磨されたウエハ（例えば半導体ウエハ）をダイシングしてチップ（例えば半導体チップ）を得る工程であってよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る電子部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を個片化することにより電子部品（例えば半導体部品）を得る工程を備えてよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る半導体部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を個片化することにより半導体部品（例えば半導体パッケージ）を得る工程を備えてよい。

[0042] 本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の一態様として、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材と他の被接続体とを接続（例えば電氣的に接続）する接続工程を備えてよい。本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材に接続される被接続体は、特に限定されず、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材であってよく、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材とは異なる被接続体であってよい。接続工程では、被研磨部材と被接続体とを直接接続（被研磨部材と被接続体とが接触した状態で接続）してよく、他の部材（導電部材等）を介して被研磨部材と被接続体とを接続してよい。接続工程は、個片化工程の前、個片化工程の後、又は、個片化工程の前後に行うことができる。

[0043] 接続工程は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材の被研磨面と、被接続体と、を接続する工程であってよく、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材の接続面と、被接続体の接続面と、を接続する工程であってよい。被研磨部材の接続面は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨面であってよい。接続工程により、被研磨部材及び被接続体を備える接続体を得ることができる。接続工程では、被研磨部材の接続面が金属部を有する場合、金属部に被接続体を接触させてよい。接続工程では、被研磨部材の接続面が金属部を有すると共に被接続体の接続面が金属部を有する場合、金属部同士を接触させてよい。金属部は、例えば銅を

含んでよい。

- [0044] 本実施形態に係るデバイス（例えば、半導体デバイス等の電子デバイス）は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材、及び、本実施形態に係る部品からなる群より選ばれる少なくとも一種を備える。

実施例

- [0045] 以下、本開示を実験例に基づいて具体的に説明するが、本開示は当該実験例に限定されるものではない。

- [0046] （セリウム酸化物粒子の作製）

電気炉を用いて表1のセリウム源を800℃、空気下で1時間焼成することによりセリウム酸化物粒子（セリア粒子）を得た。

- [0047] トリメシン酸のセリウム錯体（金属有機構造体）は、次の手順で作製した。まず、水／エタノール混合溶媒（質量比1：1）480mLに34.7g（165mmol）のトリメシン酸（1, 3, 5-BTC：1, 3, 5-Benzene tricarboxylic acid、東京化成工業株式会社製）を加えることによりトリメシン酸溶液を調製した。また、71.2g（164mmol）の硝酸セリウム六水和物（富士フィルム和光純薬株式会社製）を水20mLに加えることにより硝酸セリウム水溶液を調製した。上述のトリメシン酸溶液に上述の硝酸セリウム水溶液を加えることにより混合液Aを得た後、マグネチックスターラーを用いて混合液Aを25℃、400rpmで5時間攪拌した。混合液Aにおいて固形分（白色沈殿）が生じた後、混合液Aを15時間静置した。混合液Aを攪拌することにより固形分を再分散させた後、混合液Aを50mL遠沈管に入れ、5000rpmで5分間遠心分離した。遠心分離後の上澄み液を別容器に移した後、25℃、700rpmで上澄み液を攪拌しながらトリエチルアミン（富士フィルム和光純薬株式会社製）25.4g（251mmol、35mL）を上澄み液にゆっくり加えてpHを1.0から8.4まで上昇させることにより、固形分（白色沈殿）の生じた混合液Bを得た。混合液Bを攪拌することにより固形分を再分散させた後、混合液Bを50mL遠沈管に入れ、5000rpmで5分

間遠心分離した。遠心分離後に上澄み液を取り除き、水／エタノール混合溶媒（質量比 1 : 1）35 mL を遠沈管に入れた。固形分（白色沈殿）を再分散させた後、5000 rpm で5分間遠心分離を行った。この洗浄操作（上澄み液を取り除いた後に水／エタノール混合溶媒を加え、遠心分離を行う操作）を計2回行った後、溶媒（洗浄液）を取り除いた。加熱真空乾燥機で39時間乾燥させることにより、トリメシン酸のセリウム錯体の白色固体（ $\text{Ce}(1, 3, 5\text{-BTC}) \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）21.5 g（44.3 mmol）を得た。

[0048] 熱重量示差熱分析装置（TG-DTA、株式会社日立ハイテクサイエンス製、商品名：TG/DTA7220型）を用いて、空気気流下、測定温度範囲27～920℃、昇温速度10℃/分の条件で上述のセリウム酸化物粒子約10 mgの熱重量分析を行い、熱重量曲線の微分曲線を得た。そして、微分曲線におけるピークのピークトップ温度を求めた。結果を表1に示す。

[0049] （研磨液の調製）

上述のセリウム酸化物粒子と、リン酸二水素アンモニウムと、水とを混合することにより懸濁液を得た。セリウム酸化物粒子の含有量は、懸濁液の全質量を基準として5質量%であり、リン酸二水素アンモニウムの含有量は、セリウム酸化物粒子100質量部に対して2質量部であった。

[0050] 超音波分散装置（株式会社エスエヌディ製、商品名「US-105」）を用いて上述の懸濁液に分散処理を30分間施した。次に、ビーズミル（アシザワ・ファインテック株式会社製、商品名：ラボスターミニ、型番：DMS65）を用いて、粒径が約200 nmに至るまで上述の懸濁液中のセリウム酸化物粒子を粉砕処理（湿式粉砕）した。

[0051] 上述の粉砕処理後、遠心分離機（エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社製、商品名：CF-15R）を用いて分級処理を行うことにより上述の懸濁液中の粗大粒子を除去して粒径を約150 nmに揃えることにより砥粒の水分散液を得た。当該分級処理は、懸濁液50 gを遠沈管に入れ、1500～3700 min⁻¹で5分間遠心分離を行うことにより行っ

た。

[0052] 上述の水分散液を水で希釈することにより研磨液を得た。研磨液の全質量を基準として、砥粒の含有量は0.5質量%であり、リン酸二水素アンモニウムの含有量は0.01質量%であった。

[0053] コンパクトpHメータ（株式会社堀場製作所製、商品名：LAQUA twin）を用いて研磨液のpHを測定した。2種のpH緩衝液（pH4.01及びpH6.86）を標準緩衝液として用いてpHメータを2点校正した後、pHメータのセンサーを研磨液に入れ、pHが安定してからpHを測定した。標準緩衝液及び研磨液の液温は共に25℃であった。測定結果を表1に示す。

[0054] （研磨特性の評価）

パターンウエハ（PTW）を次の手順で作製した。まず、SEMATECH製の商品名「8” SEMATECH864」（Stop on Nitride）を準備した。このウエハは、直径200mmのシリコン基板上の一部にストッパ膜としてSiN膜を形成すると共に、SiN膜の無い部分のシリコン基板を350nmエッチングして凹部を形成し、次いで、プラズマCVD法で600nmのSiO₂膜をストッパ膜上及び凹部内に成膜して得られたウエハである。次に、このウエハを20mm×20mmに切り抜くことにより、SiNパターン（Line）及びSiO₂パターン（Space）の線幅（L/S；単位μm）が50/50であるパターン領域、並びに、SiNパターン（Line）及びSiO₂パターン（Space）の線幅（L/S；単位μm）が20/80であるパターン領域を有するパターンウエハを得た。

[0055] 研磨装置（株式会社ナノファクター製、商品名：FACT-200）において、吸着パッドを貼り付けた基体取り付け用のホルダーに上述のパターンウエハを取り付けた。研磨パッド（ニッタ・デュポン株式会社製、商品名：IC1010）を貼り付けた定盤上に、被研磨面が研磨パッドに対向するようにホルダーを載せた。上述の研磨液を供給量5mL/minで研磨パッド

上に供給しながら、研磨荷重 7 psi ($1 \text{ psi} = 6.9 \text{ kPa}$) でパターンウエハを研磨パッドに押し当てた。このとき、定盤を 120 min^{-1} で回転させ、ホルダーを定盤と共回りで回転させることにより、60秒間研磨を行った。研磨後のパターンウエハを純水でよく洗浄した後に乾燥させた。

[0056] 膜厚測定装置（東朋テクノロジー株式会社製、商品名：TohoSpec 3100）を用いて、 $L/S = 50/50$ のパターン領域及び $L/S = 20/80$ のパターン領域における SiN 上の SiO_2 （1箇所）の研磨前後の厚さの変化量を測定することにより酸化ケイ素の研磨速度を求めた。結果を表1に示す。

[0057] [表1]

		実験例			
		1	2	3	4
セリウム源		トリメシン酸のセリウム錯体	ステアリン酸セリウム	水酸化セリウム	酢酸セリウム
ピークトップ温度 [°C]		375.9	355.2	341.9	296.7
pH		8.61	8.66	8.53	8.58
研磨速度 [nm/min]	PTW(50/50)	35.3	20.9	17.0	12.9
	PTW(20/80)	53.5	37.9	25.6	25.1

請求の範囲

- [請求項1] 砥粒を得るための原料の選定方法であって、
前記原料がセリウムを含み、
前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度に基づき前記原料を選定する、原料の選定方法。
- [請求項2] 前記原料がセリウム酸化物を含む、請求項1に記載の原料の選定方法。
- [請求項3] 砥粒を得るための原料であって、
セリウムを含み、
前記原料を熱重量分析して得られる熱重量曲線の微分曲線におけるピークトップ温度が300℃以上である、原料。
- [請求項4] セリウム酸化物を含む、請求項3に記載の原料。
- [請求項5] トリメシン酸のセリウム錯体由来のセリウム酸化物を含む、請求項3に記載の原料。
- [請求項6] ステアリン酸セリウム由来のセリウム酸化物を含む、請求項3に記載の原料。
- [請求項7] 水酸化セリウム由来のセリウム酸化物を含む、請求項3に記載の原料。
- [請求項8] 請求項1又は2に記載の原料の選定方法により選定された原料、又は、請求項3～7のいずれか一項に記載の原料を粉砕する、砥粒の製造方法。
- [請求項9] 請求項8に記載の砥粒の製造方法により得られた砥粒と、水と、を混合する、研磨液の製造方法。
- [請求項10] 請求項9に記載の研磨液の製造方法により得られた研磨液を用いて被研磨部材を研磨する、研磨方法。
- [請求項11] 前記被研磨部材が酸化ケイ素を含む、請求項10に記載の研磨方法。
- [請求項12] 請求項10に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて

部品を得る、部品の製造方法。

[請求項13] 請求項10に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて
半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/017469

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*C09K 3/14*(2006.01)i; *C01F 17/235*(2020.01)i; *H01L 21/304*(2006.01)i

FI: C09K3/14 550D; C09K3/14 550Z; H01L21/304 621D; C01F17/235

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C09K3/14; C01F17/235; H01L21/304

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2023

Registered utility model specifications of Japan 1996-2023

Published registered utility model applications of Japan 1994-2023

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAplus/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2007/100093 A1 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 07 September 2007 (2007-09-07) claims, example 4, etc.	1-13
X	JP 2007-154156 A (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 21 June 2007 (2007-06-21) claims, example 4	1-13



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

05 June 2023

Date of mailing of the international search report

20 June 2023

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)

3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915

Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2023/017469

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO	2007/100093	A1	07 September 2007	TW 200738858 A claims, example 4, etc. JP 2009-113993 A	

JP	2007-154156	A	21 June 2007	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） C09K 3/14(2006.01)i; C01F 17/235(2020.01)i; H01L 21/304(2006.01)i FI: C09K3/14 550D; C09K3/14 550Z; H01L21/304 621D; C01F17/235										
B. 調査を行った分野										
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） C09K3/14; C01F17/235; H01L21/304										
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2023年</td> </tr> </table>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年
日本国実用新案公報	1922 - 1996年									
日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年									
日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年									
日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年									
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語） CAplus/REGISTRY (STN)										
C. 関連すると認められる文献										
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号								
X	WO 2007/100093 A1（日立化成工業株式会社）07.09.2007（2007 - 09 - 07） 請求の範囲、実施例 4 等	1-13								
X	JP 2007-154156 A（日立化成工業株式会社）21.06.2007（2007 - 06 - 21） 特許請求の範囲、実施例 4	1-13								
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。										
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 </td> <td> “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献						
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献									
国際調査を完了した日 05.06.2023	国際調査報告の発送日 20.06.2023									
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	権限のある職員（特許庁審査官） 堀 洋樹 4V 3034 電話番号 03-3581-1101 内線 3480									

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2023/017469

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
WO	2007/100093	A1	07.09.2007	TW	200738858	A	
				請求の範囲、実施例 4 等			
				JP	2009-113993	A	
				(ファミリーなし)			
JP	2007-154156	A	21.06.2007				